

您现在的位置: 首页>新闻中心>新闻快递

## 一室论文获得电子封装技术国际会议ICEPT2007优秀论文奖 07.08.27

2007年08月27日 浏览次数



第八届电子封装技术国际会议（ICEPT2007）于8月14日至17日在上海召开。参会人数400多位，有国内外高校、研究机构、封装企业，包括来自近20个国家和地区的专家、学者和企业家等。会议论文200多篇，其中特邀报告21篇，内容主要涉及半导体封装设计、制造和测试、以及LED封装、MEMS封装、系统封装及组装等领域。我所一室的关于封装研究的论文“Warpage and Reliability of Three-dimensional Multi-chip Module with High Density Embedded Substrate”获大会优秀论文奖（牌）。